FOR IMMEDIATE RELEASE

# SMART Modular世邁科技推出資料中心網通設備專用記憶體模組

## *滿足大量數據處理需求*

**台北，2021年6月17日 -** 全球專業記憶體與儲存解決方案的領導品牌SMART Modular[世邁科技](https://www.smartm.com/index.asp)（NASDAQ: SGH），宣佈推出高密度DuraMemory™ [VLP DIMM及Mini DIMM系列產品](https://www.smartm.com/product/list/duramemory)，適用於大規模資料中心的網路交換應用，並能大幅提升網路頻寬及可靠度，滿足資料中心對網通設備的嚴苛需求，也持續展現耕耘[資料中心網路應用](https://www.smartm.com/solution/networking-solutions)市場的決心。  
  
網通設備的記憶體可決定交換器和路由設備所儲存或傳輸的數據量，但低密度與低品質的記憶體容易造成資料傳輸的瓶頸，因此記憶體的等級與特性將會大大影響資料中心網路的整體效率。   
  
這些資料中心專屬的網通設備，如網路介面卡、路由器與交換器等等，皆已走向高度專業化，同時開發出小而緊湊型的設備發展，加上5G網路持續普及化，如何設計出更有效支援5G網路服務的網通設備已成為一大課題。SMART Modular世邁科技新推出的DuraMemory™ VLP DIMM/Mini-DIMM系列產品，具備超低延遲與高容量等網通設備記憶體所需的特點，讓各類網路架構皆能順暢連接多種設備及系統，最終建構成無縫、自動化的單一完整系統。   
  
SMART Modular世邁科技的高密度DuraMemory™ VLP或ULP DIMM/Mini-DIMM系列記憶體，相當適合超大規模資料中心的網路應用，能將資料中心網路的連接性及吞吐量提升至極致。SMART Modular世邁科技DRAM產品行銷總監Arthur Sainio表示，「SMART Modular世邁科技致力於提供客戶最合適的網通設備記憶體解決方案，不僅能支援所有類型的資料中心網路設備，同時也協助對應各種關鍵任務的使用需求。」

### 針對資料中心網路設備OEM業者，SMART Modular世邁科技可提供三大效益：

* 符合資料中心網通設備需求的完整記憶體產品線
* 專業的資料中心網通設備記憶體設計與支援
* 長期產品供貨週期，確保設備使用壽命與運作效能

欲了解更多記憶體解決方案新品資訊，請聯繫[SMART Modular世邁科技業務團隊](https://www.smartm.com/support/contact-us/sales-request)或e-mail至[info@smartm.com](mailto:info@smartm.com)。

### 關於SMART Modular世邁科技

全球專業記憶體與儲存解決方案的領導者SMART Modular世邁科技於美國加州成立超過三十年，為美國那斯達克掛牌上市公司 (NASDAQ: SGH)，致力於開發中高階工業及企業級嵌入式記憶體產品，包含DRAM記憶體模組、SSD固態硬碟、混合式解決方案等，除了標準化與強固型規格外，更針對不同產業應用提供客製化服務，跨足電腦、網通、電信、儲存設備、移動裝置、軍事、航空及工業應用等。SMART Modular世邁科技提供高度客製化的產品設計能力、嚴謹可靠的測試服務與即時專業的技術支援，並與全球領導OEM客戶緊密合作，從產品設計到上市，均能提供高效可靠的解決方案，滿足各類工控產業的需求。更多資訊請參考: <http://www.smartm.com>